

2018年3月29日

各 位

会 社 名 株式会社フジミインコーポレーテッド  
代表者名 代表取締役社長 関 敬 史  
(コード番号 5384 東証・名証一部)  
問合せ先 取締役財務本部長 鈴木 彰  
(TEL 052-503-8181)

### キャボットマイクロエレクトロニクス社との共同開発に関するお知らせ

株式会社フジミインコーポレーテッド（本社：愛知県清須市、代表取締役社長：関 敬史）は、半導体用CMP研磨剤のリーディング・カンパニーであり研磨パッドでも世界2位のシェアを持つキャボットマイクロエレクトロニクス社（Nasdaq: CCMP、本社：米国イリノイ州オーロラ市、社長兼CEO：デービッド・リー）と、半導体向け先端CMPの特定用途において両社が共同開発する予定であることを本日発表しました。

フジミインコーポレーテッドとキャボットマイクロエレクトロニクスは、今回の提携において双方の得意領域と経験を活用することにより、AR（拡張現実）、AI（人工知能）、自動運転技術、高性能コンピューティング、5Gワイヤレス・ブロードバンドなどの日々増加する半導体用途における革新的CMPソリューションに対する顧客からの要望に応えることができるものと確信しています。

フジミインコーポレーテッド社長の関 敬史は、「新技術を先端ロジック及びメモリー半導体にもたらしやすくキャボットマイクロエレクトロニクス社と協働できることを嬉しく思います。今回の構想は両社が従来から力を注いできた、お客様が抱えておられる非常に難易度の高い分野での技術課題に対するソリューションにつながる画期的なCMP製品の開発に資するものであり、これを起点とした今後の両社の協業発展に期待しています。」と述べています。

キャボットマイクロエレクトロニクス社長兼CEOのデービッド・リー氏は、「今回の初提携がお客様と両社にもたらす機会の増大を大変嬉しく思います。フジミインコーポレーテッドとキャボットマイクロエレクトロニクスは共に材料開発のリーダーであり、高品質かつ高性能のCMPソリューションを提供してきた実績があります。その両社が協力することにより、過去に例をみない成長を続ける半導体CMP分野において、より高度なソリューションを開発出来るものと確信しています。」と述べています。

なお、本提携が平成30年3月期及び平成31年3月期の連結業績に与える影響は軽微であると見込んでおりますが、今後、開示事項に該当する事象が発生しましたら速やかに開示いたします。

以 上